

常规日光灯铝基板 1.5/米 2835LED 高品质

产品名称	常规日光灯铝基板 1.5/米 2835LED 高品质
公司名称	深圳市强能达电路有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:1060板材 型号:强能达铝基板
公司地址	深圳市宝安区沙井后亭新村西三巷9号
联系电话	86-075533513307 13728666058

产品详情

1、表面工艺：喷锡、镀金、沉金 /松香、osp膜等。2、pcb层数layer 1-20层3、最大加工面积单面/双面板850x650mm single/4、板厚0.3mm-3.2mm 最小线宽0.10mm 最小线距0.10mm5、最小成品孔径 ϕ 0.2mm6、最小焊盘直径0.5mm7、金属化孔孔径公差 $0.8 \pm 0.05\text{mm}$ $> 0.8 \pm 0.10\text{mm}$ 8、孔位差 $\pm 0.05\text{mm}$ 9、绝缘电阻 $> 10^{14}$ (常态) 10、孔电阻 300μ 11、抗电强度 1.6kv/mm12、抗剥强度1.5v/mm13、阻焊剂硬度 $> 5\text{h}$ 14、热冲击 288 10sec15、燃烧等级 94v-016、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度 board twist $< 0.01\text{mm/mm}$ 离子清洁度 < 1.56 微克/cm²17、基材铜箔厚度：0.5oz 1oz 2oz 3oz18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米19、常用基材：fr-4、fr-5、cem-1、cem-3、94vo、94hb fpc f4bm-220、客供资料方式：gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads2005文件、autocad文件、orcad文件、菲林、样板等

铝基板介绍：

特点目前，led应用的散热问题是led厂家最头痛的问题。散热基板是一种提供热传导的媒介，led 散热基板 散热模块，它可以增加led底部面积，增加散热面积，主要由铜箔电路/陶瓷粉末+高分子/铝基板组成。散热基板于led产业应用中具有高导热率、安全性、环保性等功能。下面介绍采用铝材料的基板，因为铝的导热系数高，散热好，可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板，具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。

采用表面贴装技术 (smt) ; 在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理 ; 降低产品运行温度 , 提高产品功率密度和可靠性 , 延长产品使用寿命 ; 缩小产品体积 , 降低硬件及装配成本 ; 取代易碎的陶瓷基板 , 获得更好的机械耐久力。pcb铝基板的结构pcb铝基覆铜板是一种金属线路板材料、由铜箔、导热绝缘层及金属基板组成 , 它的结构分三层 :

circuit layer线路层 : 相当于普通pcb的覆铜板 , 线路铜箔厚度1oz至10oz。

dielectric layer绝缘层 : 绝缘层是一层低热阻导热绝缘材料。厚度为 : 0.003 " 至0.006 " 英寸是铝基覆铜板的核心技术所在 , 已获得UL认证。

base layer基层 : 是金属基板 , 一般是铝或可所选择铜。铝基覆铜板和传统的环氧玻璃布层压板等。

pcb铝基板由电路层、导热绝缘层和金属基层组成。电路层 (即铜箔) 通常经过蚀刻形成印刷电路 , 使组件的各个部件相互连接 , 一般情况下 , 电路层要求具有很大的载流能力 , 从而应使用较厚的铜箔 , 厚度一般35 μ m~280 μ m ; 导热绝缘层是pcb铝基板核心技术之所在 , 它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成 , 热阻小 , 粘弹性能优良 , 具有抗热老化的能力 , 能够承受机械及热应力。ims-h01、ims-h02和led-0601等高性能pcb铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术 , 使其具有极为优良的导热性能和高强度的电气绝缘性能 ; 金属基层是铝基板的支撑构件 , 要求具有高导热性 , 一般是铝板 , 也可使用铜板 (其中铜板能够提供更好的导热性) , 适合于钻孔、冲剪及切割等常规机械加工。

pcb材料相比有着其他材料不可比拟的优点。适合功率元件表面贴装smt工艺。无需散热器 , 体积大大缩小、散热效果极好 , 良好的绝缘性能和机械性能。

pcb材料相比有着其它材料不可比拟的优点。适合功率组件表面贴装smt工艺。

无需散热器 , 体积大大缩小、散热效果极好 , 良好的绝缘性能和机械性能。

导热系数导热系数又称为热传导系数 , 热传导率 , 热导率。它表示物质热传导性能的物理量 , 是当等温面垂直距离为1m,其温度差为1℃,由于热传导而在1h内穿过1m²面积的热量 (千卡)。它的表示单位为 : 千瓦/米.小时. [kw/(m.h.)]

如果需要基板材料担负更大的散热功效 , 所采用的基板材料要求是具有高导热系数 (热传导率)。如果需要通过基板材料能够起到隔绝热的功效 , 那么就希望所用的基板材料的导热系数越低越好。

铝基板的热阻 : 定量描述一种物体的导热性能 , 可以用导热系数 , 也可以用另外一种特性参数来表达 , 它就是“热阻”。有关专著提出 : 导热系数适于表征一种均匀材质的材料的导热性能 , 而作为多种材料复合的基板材料 , 它的导热性能更适用于用热阻来定量描述。

在热传导的方式下 , 物体两侧的表面温度之差 (简称温差) 是热量传递的推动力。热阻 (rr) 等于这种温差 (t1-t2)除以热流量 (p)。因此 , 基板材料的热阻越小说明它的导热性越高。

铝基板型号与参数现市场上根据需求一般铝基板可分为1.0mm , 1.5mm和2.0mm三种厚度 , 基本参数为普通型和高导热型。普通型一般导热系数在1.0以上 (铝基板基础导热率) , 高导型加了一层导热层 , 材料较贵 , 且工艺复杂 , 但导热性能优越 , 一般为1.5-2.0 , 也可根据需要定制 (可达3.0以上)。另一重要参数为耐压 , 一般普通版为500v-2500v之间 (视板材品质而定) , 优秀的板材可达3000v以上 , 也可定制 (

可达7000v以上)。

本产品的绝缘层厚度为常规板，阻燃特性是VO板，机械刚性为刚性，绝缘材料是有机树脂，基材为铝，营销价格是特价，加工定制为是，导热系数是1.2，增强材料为合成纤维基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质为热销，营销方式是厂家直销，耐压为2200V，型号是强能达铝基板，加工工艺为电解箔，层数是单面，品牌为1060板材，